

MMBT5551

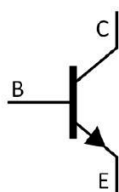


MMBT5551

SOT-23 塑封封装 NPN 半导体三极管。

击穿电压高,可与 MMBT5401 互补。

用于普通高压放大。



:

:

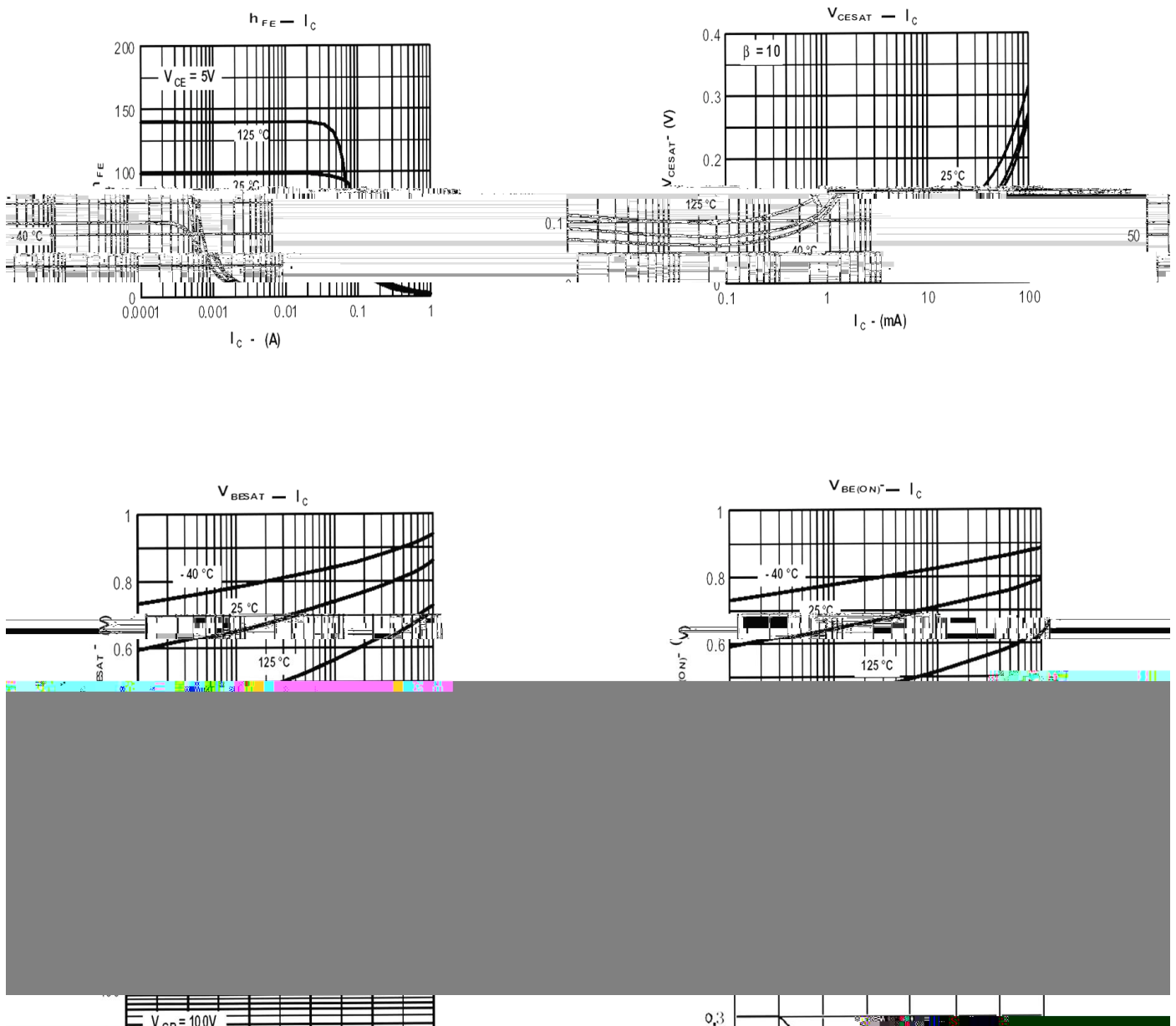
/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

参数	符号	数值	单位
			℃
		~	℃

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位

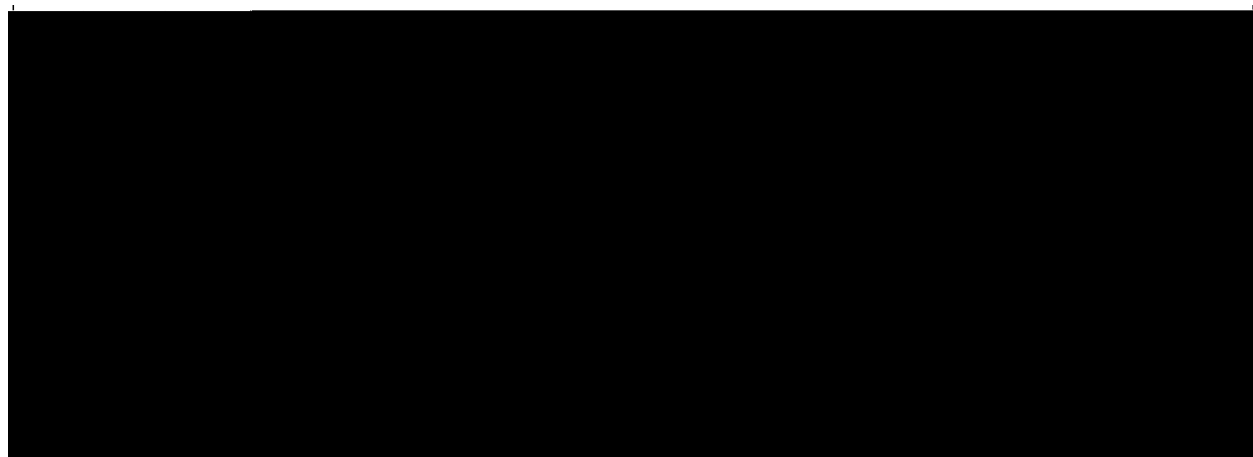
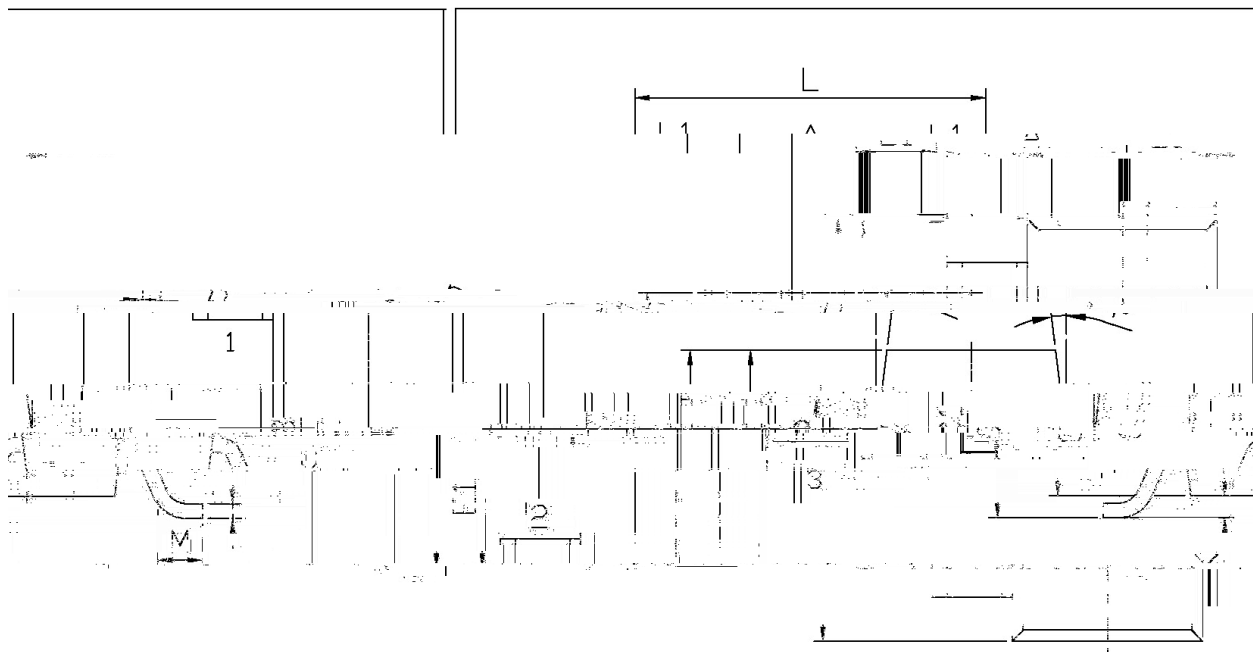
/ Electrical Characteristic Curve



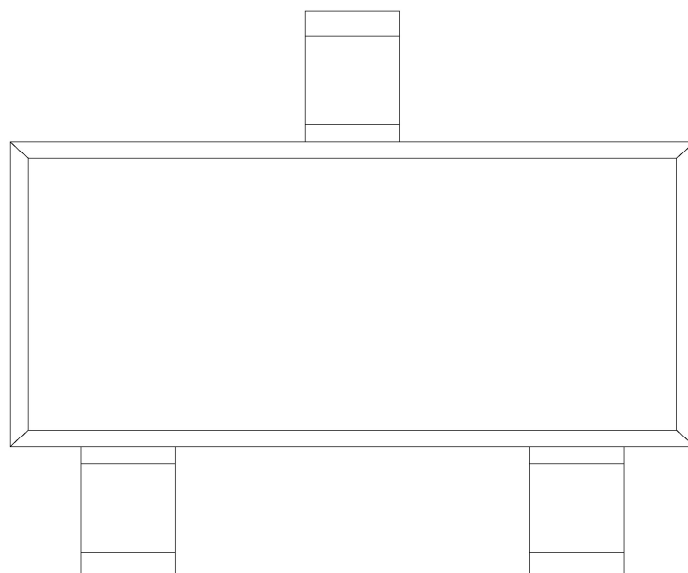
/ Package Dimensions

SOT-23

单位: mm



/ Marking Instructions



说明：

H： 为公司代码

G1： 为型号代码

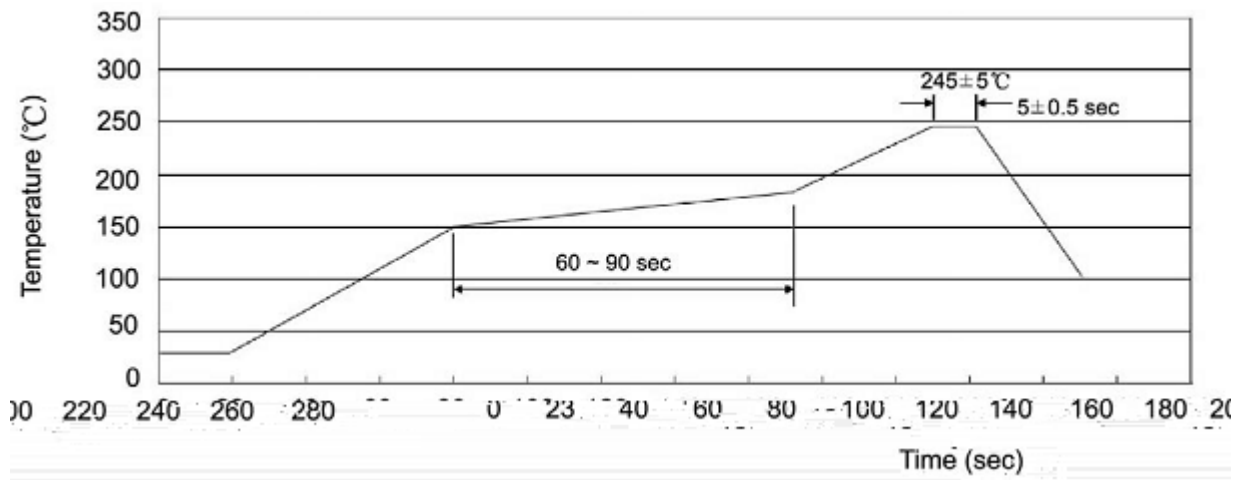
A： 为 档次代码

：

：

：

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



± °C ± °C ± °C ± °C

°C °C

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± °C ± °C °C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205